

昆山东威科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位及人员名称	1、中金公司 丁健；悦溪基金 陈旻、任云鹤；玖歌投资 田显斌、苏凯；招商基金 孙麓深；GIC 谢楚轩；远信投资 高亮；紫金矿业 李世春；海雅金控 杨靖； 2、国泰君安 欧阳蕤、袁强、王楠瑀、魏巍；上海笃熙 稟泰私募 唐福全；上海安合投资 时国峰。
调研时间	2024年2月23日、2024年2月27日
会议地点	昆山公司一楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监：周湘荣（出席第1、2场） 新能源膜材事业部总经理：张振（出席第1场） 董事会秘书：徐佩佩（出席第1、2场）

投资者关系活动内容记
录

主要问题：

1. 公司2023年业绩快报已披露，请问什么原因导致净利润下降幅度超过了收入下降幅度？

答：相比于受疫情影响的2022年，2023年公司的差旅费、销售费用等费用均有所增加。同时，由于下游终端产品的景气下行，公司下游客户受到影响，应收款有所增长，导致坏账损失的增加，因此净利润下降幅度超过了收入下降幅度。

2. 请问公司2023年度传统PCB业务订单情况如何？

答：2023年以手机、平板、电脑等为代表的消费电子行业持续疲软，去库存压力较大。虽然下游终端产品的景气下行给公司PCB电镀设备业绩增长带来压力，但是由于新能源汽车、AI、算力等快速发展带来高阶电路板的需求，总体来说公司2023年PCB业务订单方面表现不错，与2022年相比有所增加。

3. 请问公司对2024年镀PCB业务订单是怎么样的预期？

答：公司比较看好2024年PCB业务，今年1-2月新增订单已过亿。虽然行业仍处于去库存阶段，但去国外投资建厂的客户较多，带动了国外订单的增加，目前已有较多国内客户在与我们沟通国外厂区的设备需求，部分客户已下订单。此外，在AI、高阶伺服器、电动车的高速发展下，对厚铜、细线路、高阶HDI及薄板需求递增，也加大了公司水平湿制程设备的市场需求。作为PCB行业的“工业母机”，预计2024年PCB领域的订单将会有较好的增长空间。

4. 关于设备的应用领域，公司会有什么新的未来预期？

答：公司设备类型丰富，技术储备雄厚，公司在现有技术及设备的基础上不断研发新设备，应用到新的行业与领域，部分相关设备已在研发、洽谈中。未来公司将不断延伸产品应用领域，如钢铁、医疗器械、电池外壳、玻璃基板、IGBT等应用场景。

5. 公司的未来国外业务布局是怎么安排的？

答：在2020年之前，公司国外业务占比大概在10%左右；后因疫情影响，国外业务占比有所下降。目前公司正在积极拓展国外市场，2023年成立泰国公司，投资建厂，为公司的国外客户进行更好的设备生产、销售、安装等服务。目前泰国公司进展顺利，预计客户的新增订单将会有比较好的预期，对此我们充满信心。

6. 光伏镀铜第三代设备目前进度如何？

答：第三代镀铜设备目前在客户处已基本完成调试，进入试生产阶段，电镀的技术指标已基本达标。待客户最终验收通过后，该款设备有望在光伏领域有突破性发展，赢得光伏领域客户的认可。

7. 对于复合集流体行业的复合铜箔产业化，公司如何看？

答：公司坚定地看好复合铜箔未来发展趋势，长期看复合铜箔成本优势很清楚。无论是PP还是PET，技术路径已经完全走通。公司积极开拓欧美、东南亚等地复合铜箔设备市场，年前已有客户陆续签订合同。目前公司部分客户的国外送检已基本通过。未来在国内外终端客户市场验证的影响下，复合铜箔产业化趋势值得期待。

附件清单	无
日期	2024年2月23日、2024年2月27日